

# 酸エッチングおよび洗浄プロセス用 Ptfе シリコンウェハホルダー 2 4 6 8 インチ カスタマイズ可能 耐高温

商品番号: PL-CP158



## 前書き

過酷な酸エッチングおよび洗浄プロセス向けに設計された高純度PTFE製シリコンウェハホルダー。2インチから8インチのウェハに最適化された、頑丈でカスタマイズ可能なこのキャリアは、B2B調達における最も要求の厳しい半導体製造環境において、汚染のない取り扱いと熱安定性を保証します。

## [詳細を学ぶ](#)

用途	説明	主な利点
半導体エッチング	誘電体層を除去するために、濃縮HFまたはBOE（バッファードオキサイドエッチ）溶液中でウェハを取り扱う。	侵襲性の高い酸に対する優れた耐性により、キャリアの長期的な耐久性が保証される。
RCA洗浄プロセス	高温でのSC-1およびSC-2溶液を使用して、有機および金属汚染物質を除去する。	高い熱安定性により、高温酸化浴中の変形が防止される。
太陽電池セル生産	高効率太陽電池の製造中におけるシリコンウェハのテクスチャリングおよび洗浄。	堅牢な設計により、一貫した信頼性で大量産業スループットを処理する。
MEMS製造	複雑な深反応性イオンエッチングおよびウェットリリースプロセス中に基板を確実に保持する。	精密加工されたスロットが、繊細な微小機械構造を接触損傷から保護する。
ピラニアエッチ洗浄	硫酸と過酸化水素の混合物中でウェハを処理し、重有機物を除去する。	材料は強力な酸化攻撃に対して影響を受けず、装置の劣化を防止する。
ナノテクノロジー研究	実験的な化学気相成長または液相処理におけるカスタム基板の専門的な取り扱い。	完全なカスタマイズにより、非標準のウェハサイズと独自の形状サポートが可能。
光エレクトロニクス組立	エピタキシャル成長または薄膜堆積前のサファイアまたはGaAsウェハの洗浄。	PTFE材料の純度により、光学デバイスにおける微量金属干渉のリスクが排除される。
仕様カテゴリ	PL-CP158のパラメータ詳細	可用性/オプション
モデルシリーズ	PL-CP158 シリコンウェハキャリア	標準およびカスタム設計
主要材料	高純度PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）	PFAオプションはリクエストに応じて利用可能
対応ウェハサイズ	2インチ、4インチ、6インチ、8インチ	任意の直径に完全にカスタマイズ可能
スロット構成	容量とピッチはプロジェクトごとに定義	ユーザー仕様に合わせてカスタマイズ
温度範囲	極低温から260°Cまでの動作	プロセス依存のカスタマイズ
耐薬品性	酸、塩基、溶剤の全範囲	普遍的化学互換性
製造方法	5軸CNC精密加工	特注形状利用可能
排水機能	カスタマイズ可能な底面/側面排水口	特定のバス流量に最適化
ハンドル設計	取り外し可能または一体型の手動/ロボットハンドル	ツール互換性のためにカスタマイズ

用途	説明	主な利点
仕様カテゴリ	PL-CP158のパラメータ詳細	可用性/オプション
純度グレード	微量分析および半導体グレード	認定高純度材料